

NEWS RELEASE

パッケージ基板加工のさらに高い生産性を実現

三菱電機基板穴あけ用レーザー加工機「GTF4 シリーズ」発売

三菱電機株式会社は、スマートフォンやタブレットPCなどに使用されるパッケージ基板^{※1}に適した基板穴あけ用レーザー加工機の新製品として、「GTF4 シリーズ」を5月22日に発売します。Synchrom（シンクローム）テクノロジー^{※2}の採用に加え、独自開発の高精度ガルバノスキャナー^{※3}とパッケージ基板加工に特化したレーザー発振器の搭載により、さらに高い生産性を実現します。

※1 ICサブストレート基板。ICチップの直下に配置される中継基板

※2 加工テーブルの駆動・停止後にレーザー加工を実施していた従来の制御方式と異なり、加工テーブルの駆動とレーザー加工を同時に行うことで非加工時間を約50%短縮した制御方式

※3 ミラーを高速で駆動し、レーザー光を位置決めする装置



三菱電機基板穴あけ用レーザー加工機「ML605GTF4-5350UM」

新製品の特長

1. Synchromテクノロジーの採用により、さらに高い生産性を実現

- ・Synchromテクノロジーの採用とガルバノスキャナーの高速化により生産性を約10%向上^{※4}
- ・パッケージ基板加工専用のレーザー発振器（ML5350UM）の搭載と、4ビーム同時加工光学系の採用により、さらに高い生産性を実現

※4 従来機GTF3シリーズとの比較（加工内容、加工材料などによって異なります）

2. 高精度ガルバノスキャナーの搭載などにより、さらに高精度な加工を実現

- ・独自開発の高精度ガルバノスキャナーの搭載や制御方式の改良に加え、加工中の機械変形を抑制したプラットフォームの採用により、さらに高精度な加工を実現

発売の概要

製品名	形名	発売日	目標販売台数
基板穴あけ用レーザー加工機 GTF4シリーズ	ML605GTF4-5350UM	5月22日	年間50台

発売の狙い

スマートフォンやタブレットPCなどの電子機器において、さらなる小型化・高機能化の需要が拡大している中、半導体パッケージ基板の製造工程では、基板穴あけ用レーザー加工機によるさらに高い生産性の実現が求められています。

当社は今回、このニーズに応えるために、Synchrom テクノロジーの採用に加え、独自開発の高精度ガルバノスキャナーとパッケージ基板加工に特化したレーザー発振器を搭載した基板穴あけ用レーザー加工機「GTF4 シリーズ」を発売します。

主な仕様

項目		仕様
システム	形名	ML605GTF4-5350UM
	外形寸法(mm)※5	4780W×3370D×2270H
	機器質量(kg)※5	9000
加工機	XY テーブル	加工ワーク寸法 (mm) 610×510
		最大送り速度 (m/min) 50
発振器	レーザーの種類	CO ₂ レーザー
	出力(W)	210
	設定周波数(Hz)	10～10000

※5 加工機・発振器・制御装置・冷却装置・ワーク吸着装置・電源盤を含めた寸法・質量
基板搬送装置（オプション）の仕様によって寸法・質量は異なります

環境への貢献

製造現場における生産性の向上により、消費電力の削減に貢献します。

製品担当

三菱電機株式会社 名古屋製作所
〒461-8670 愛知県名古屋市東区矢田南五丁目 1 番 14 号
TEL 052-712-2209 FAX 052-712-3483

お客様からのお問い合わせ先

三菱電機株式会社 産業メカトロニクス事業部
〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号
TEL 03-3218-6540 FAX 03-3218-6822